

## 全国集成电路和硅材料学术会议简讯

中国电子学会半导体与集成技术学会和电子材料学会联合举办的《全国集成电路和硅材料学术会议》于1979年12月29日至1980年1月6日在福州市举行。这是建国以来第一次全国性的半导体集成电路和硅材料专业学术会议。来自全国24个省、市、自治区220个单位的科研、工业部门和高等院校的514名科学工作者、工程技术人员参加了会议。

中国电子学会常务理事、电子材料学会主任林兰英同志、中国电子学会常务理事、半导体与集成技术学会主任王守武同志分别主持了开幕式和闭幕式，并致了词。中共福建省委、省人民政府的主要领导廖志高、马兴元、李正亭、张格心、温附山等同志应邀参加了闭幕式。著名半导体专家王守武、林兰英、黄敞在大会上分别作了《西德半导体科学技术发展特点》、《用于N-MOS 4096位随机存贮器的硅材料的研究》、《集成电路的生产、试制和研究》的特邀报告。

这次学术会议共报告论文209篇，内容包括了半导体材料制备及性能、器件及材料物理、理化分析测试、新工艺技术、集成电路及其应用等。

这次学术会议反映了当前我国半导体集成电路和硅材料科研生产的基本状况，是对我国七十年代末期集成电路和硅材料研制生产工作的一次小结，也是对我国半导体科学技术的一次检阅。与会代表认为，我国半导体事业正在发展，工作在深入，取得了一定成绩，学术水平也有所提高，科技队伍在逐步成长。除学术交流外，大家还就如何发展我国集成电路和硅材料的工业生产，如何发展我国的半导体科研事业、如何开展两个专业学会的学术活动，进行了热烈的讨论，提出了宝贵意见。

会议决定：81年10月中旬在广州召开第二次大规模集成电路和硅材料学术会议。

(冯应章)

## NEWS IN BRIEF—NATIONAL CONFERENCE ON INTEGRATED CIRCUITS AND SILICON MATERIALS

Fuzhou, Fujian, Dec. 29, 1979—Jan. 6, 1980.